

한화비전

2024년 4분기 실적발표

Disclaimer

본 자료의 실적과 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 (잠정)자료로 외부 감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분들의 편의를 위하여 작성된 것으로 미래에 대한 예측정보를 포함하고 있습니다.

이러한 예측 정보는 이미 알려진 또는 아직 알려지지 않은 위험과 시장 상황, 기타 불명확한 사정 또는 당초 예상하였던 사정의 변경에 따라 영향을 받을 수 있고 실제 결과와 이에 기재되거나 암시된 내용 사이에 차이가 있을 수 있으며, 시장 환경의 변화와 전략 수정 등에 따라 예고 없이 달라질 수 있습니다.



1. 2024년 4분기 실적발표

▼ 4Q24 손익계산서 (연결)

(단위 : 억원)

구분	3Q24	4Q24	QoQ
매출액	1,395	3,538	153.6%
매출원가	702	1,701	142.2%
매출총이익	694	1,837	164.8%
매출총이익률	49.7%	51.9%	2.2%p
판매비와 관리비	413	1,205	191.8%
연구개발비	227	688	203.0%
영업이익	54	-55	적자전환
영업이익률	3.9%	-1.6%	-8.8%p
영업외손익	-153	353	흑자전환
법인세차감전순이익	-99	298	흑자전환
법인세비용	32	-130	-
당기순이익	-131	428	흑자전환
당기순이익률	-9.4%	12.1%	21.5%p

주1) 3분기 실적은 한화비전 분할설립일(24년 9월 1일) 이후 한달 실적만 반영되었습니다.

▼ 주요내용

[시큐리티]

- 북미를 중심으로 구주, 아시아 전역에서 매출 증가세 지속
- 우호적인 환율효과 지속으로 인한 영업외이익(외화환산이익) 증가

[산업용장비]

- 중국 경기침체 장기화에 따른 매출 감소
- 매출감소로 인한 고정비 부담 증가로 적자폭 확대

[반도체설계]

- 자회사(뉴블라) 청산 관련 비용 발생

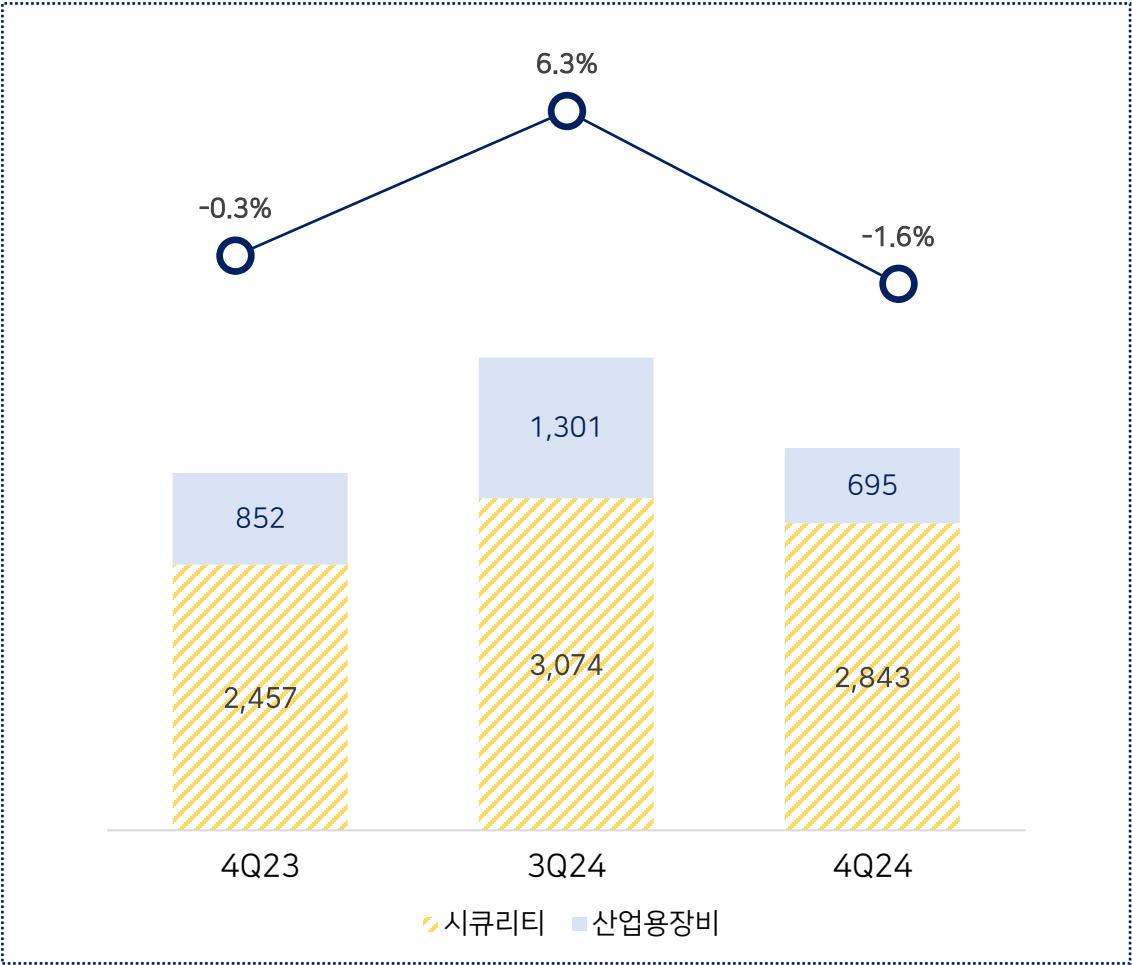
분할신설법인 추정손익 (비교 편의를 위한 조정실적)

» 한화비전은 '24년 9월 1일 신설되어 그 이전 매출 및 이익은 존재하지 않습니다

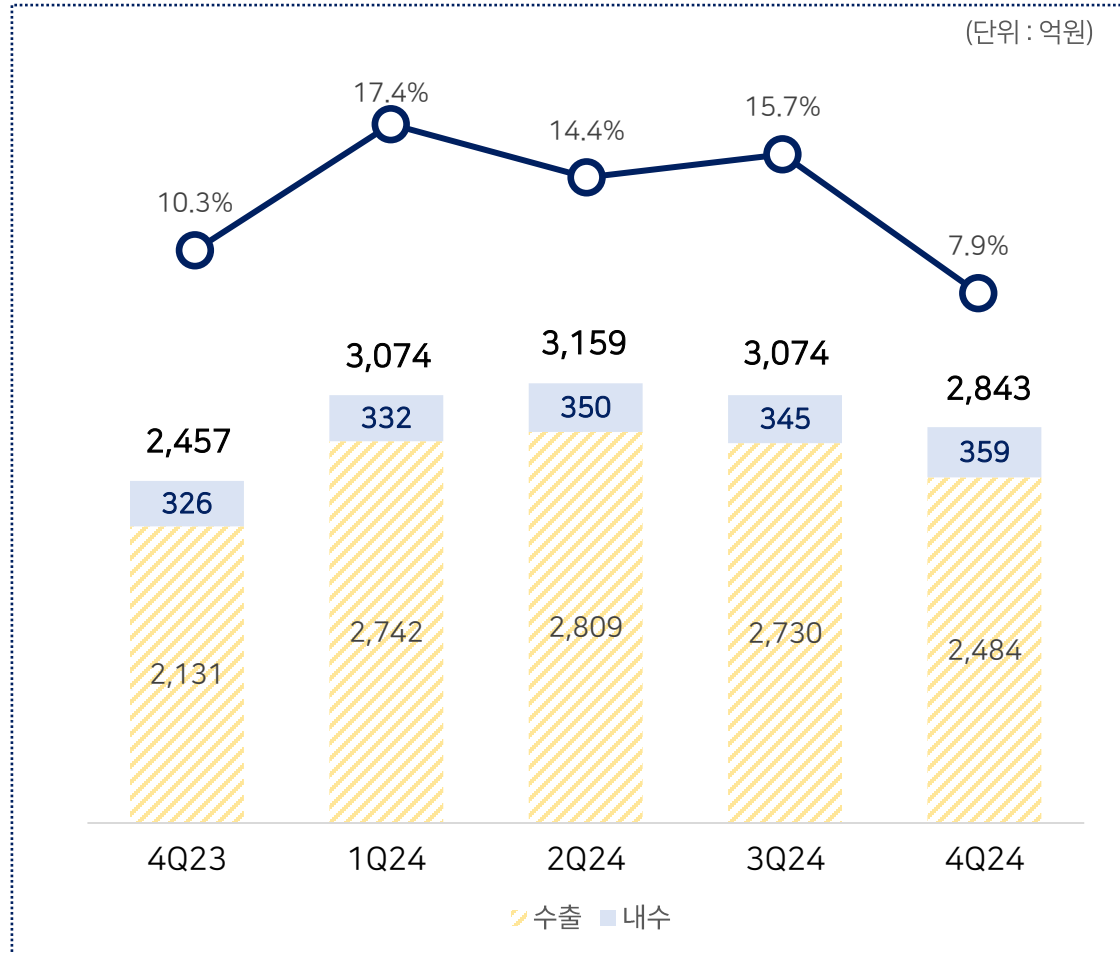
[투자자들의 이해를 돕고자 하기 실적은 분할 전 존속법인이 작성한 사업보고서 또는 IR자료 내 분할 신설예정 사업부분과 그 존속법인의 매출 및 이익의 단순 합산입니다.]

▼ 주요 매출 및 영업이익

구분	4Q23	3Q24	4Q24	증감률	
				YoY	QoQ
매출액	3,353	4,375	3,538	5.5%	-19.1%
시큐리티	2,457	3,074	2,843	15.7%	-7.5%
수출	2,131	2,730	2,484	16.6%	-9.0%
내수	326	345	359	10.1%	4.1%
산업용장비	852	1,301	695	-18.4%	-46.6%
SMT	707	693	499	-29.4%	-28.0%
그 외 기타	145	608	196	35.2%	-67.8%
반도체설계	44	-	-	-	-
영업이익	-10	275	-55	적자확대	적자전환
(%)	-0.3%	6.3%	-1.6%	-4.6%p	-7.9%p
시큐리티	254	511	224	-11.8%	-56.2%
(%)	10.3%	16.6%	7.9%	-2.5%p	-8.7%p
산업용장비	-218	-49	-241	적자확대	적자확대
(%)	-25.6%	-3.8%	-34.7%	-9.1%p	-30.9%p
반도체설계	-27	-124	-38	적자확대	적자축소
(%)	-61.4%	-	-	-	-



▼ 분기별 매출 및 영업이익률



▼ 주요 내용

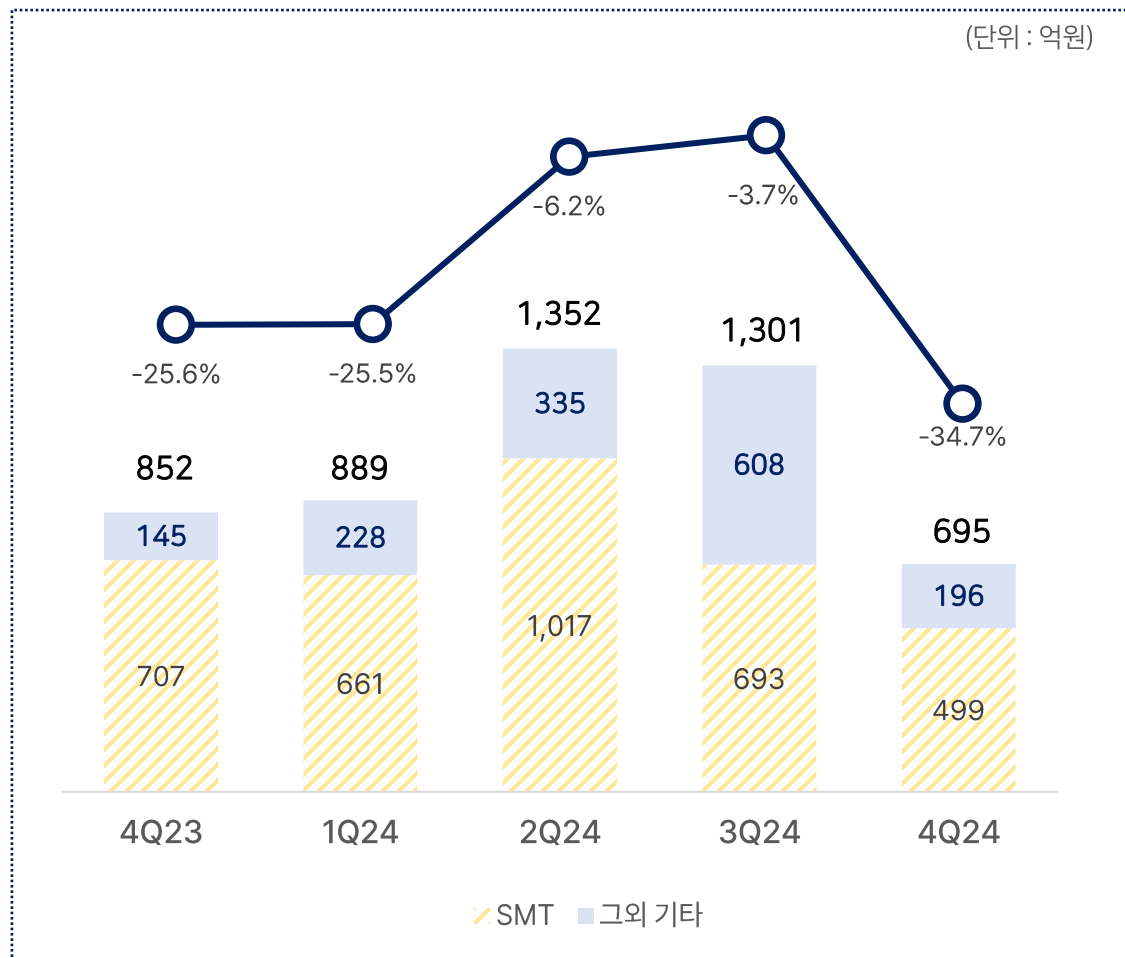
[시큐리티]

- 4Q24 매출액 2,843억원, 영업이익률 7.9% 달성
- 연말 재고조정으로 인한 매출감소 및 판관비 증가로 인한 이익 감소 (QoQ)
- 미주지역 포함한 글로벌 전역에서 감시장비 수요 증가 및 우호적인 환율효과 유지되며 매출 증가 (YoY)

[반도체 설계]

- 자회사(뉴블라) 청산 비용 발생하며 이익감소에 영향
→ 4분기 일회성 비용 정리되며, '25년 1분기 부터 영업이익률 회복 전망

▼ 분기별 매출 및 영업이익률



▼ 주요 내용

[공통]

- 4Q24 매출액 695억원, 영업이익률 -34.7% 기록함

[SMT]

- 4Q24 매출액 499억 기록함
- 경기침체 및 중화권 매출 감소로 인해 직전분기 대비 매출 하락
- 매출감소로 인한 고정비 증가로 적자폭 확대

[그외 기타]

- 그 외 기타 부문매출액 196억 기록함
- 반도체 장비부문 매출 및 이익 감소 (QoQ)

연결재무제표 (4Q24)



(단위 : 억원)

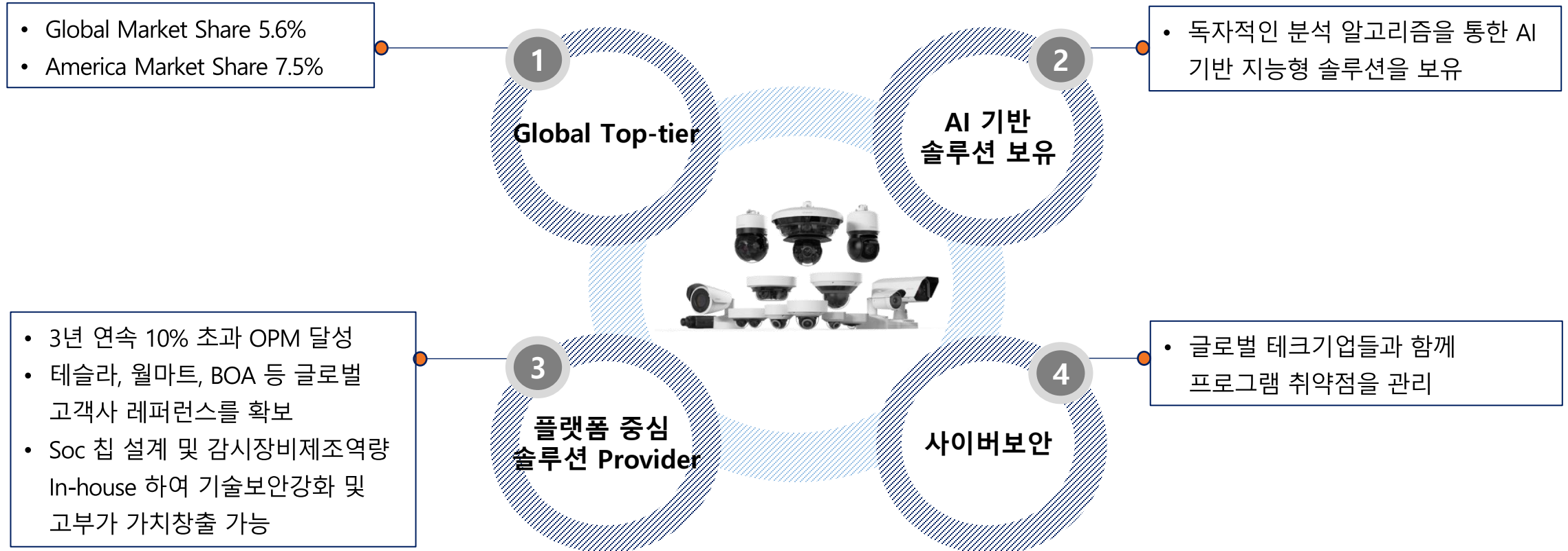
구분	4Q24
자산	
유동자산	9,962
현금및현금성자산	1,538
기타금융자산	553
매출채권및기타채권	4,562
재고자산	3,088
기타유동자산	222
비유동자산	5,949
장기매출채권및기타채권	85
사용권자산	404
유형자산	3,048
무형자산	856
기타비유동금융자산	36
기타비유동자산	77
이연법인세자산	1,444
자산총계	15,911

(단위 : 억원)

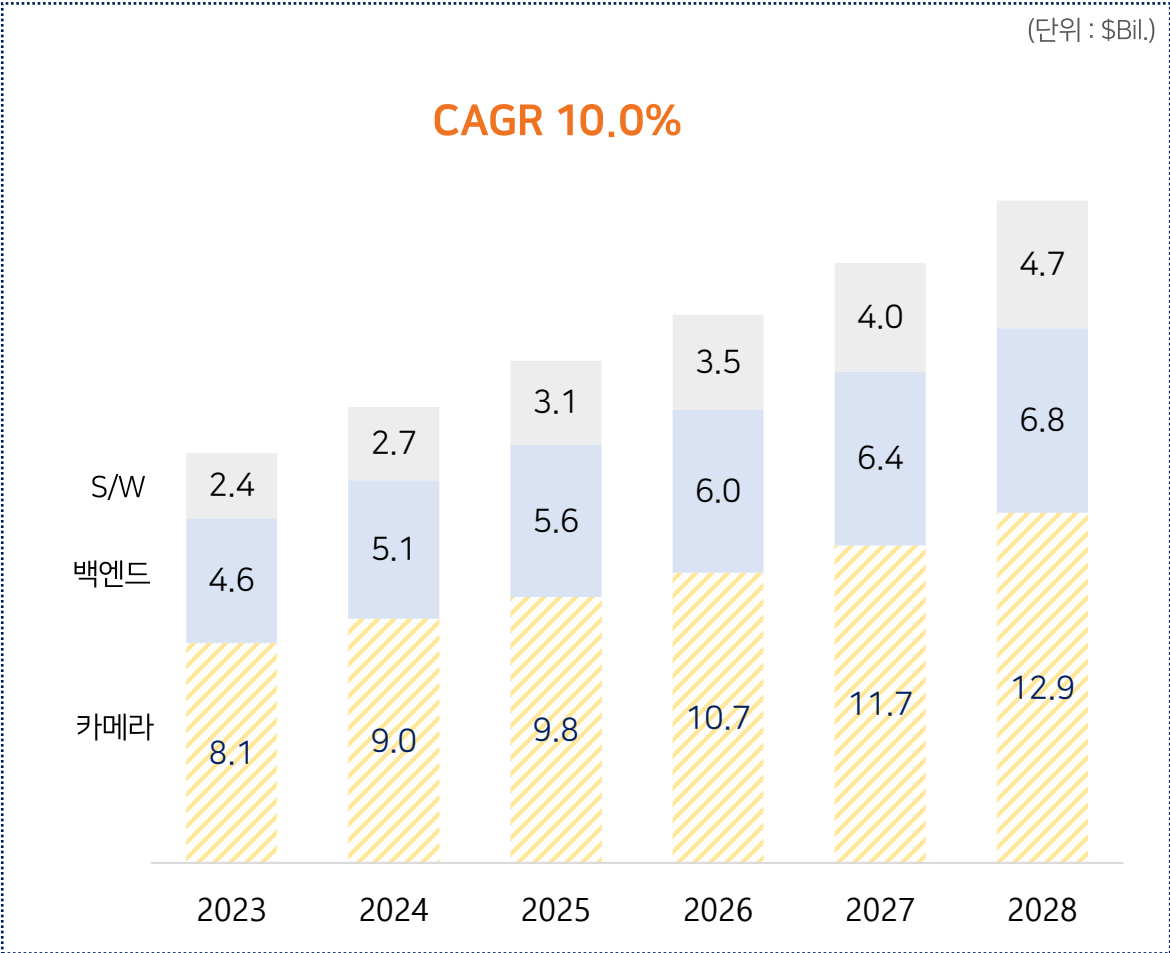
구분	4Q24
부채	
유동부채	5,301
매입채무및기타채무	2,025
유동성차입금	2,284
미지급법인세	493
리스부채	137
파생상품부채	53
기타유동부채	311
비유동부채	2,363
장기매입채무및기타채무	757
장기리스부채	236
종업원급여부채	1,145
이연법인세부채	205
부채총계	7,664
자본	
지배기업주주지분	8,229
자본금	252
자본잉여금	6,986
자본조정	-39
기타포괄손익누계액	907
이익잉여금	123
비지배지분	19
자본총계	15,911



2. APPENDIX

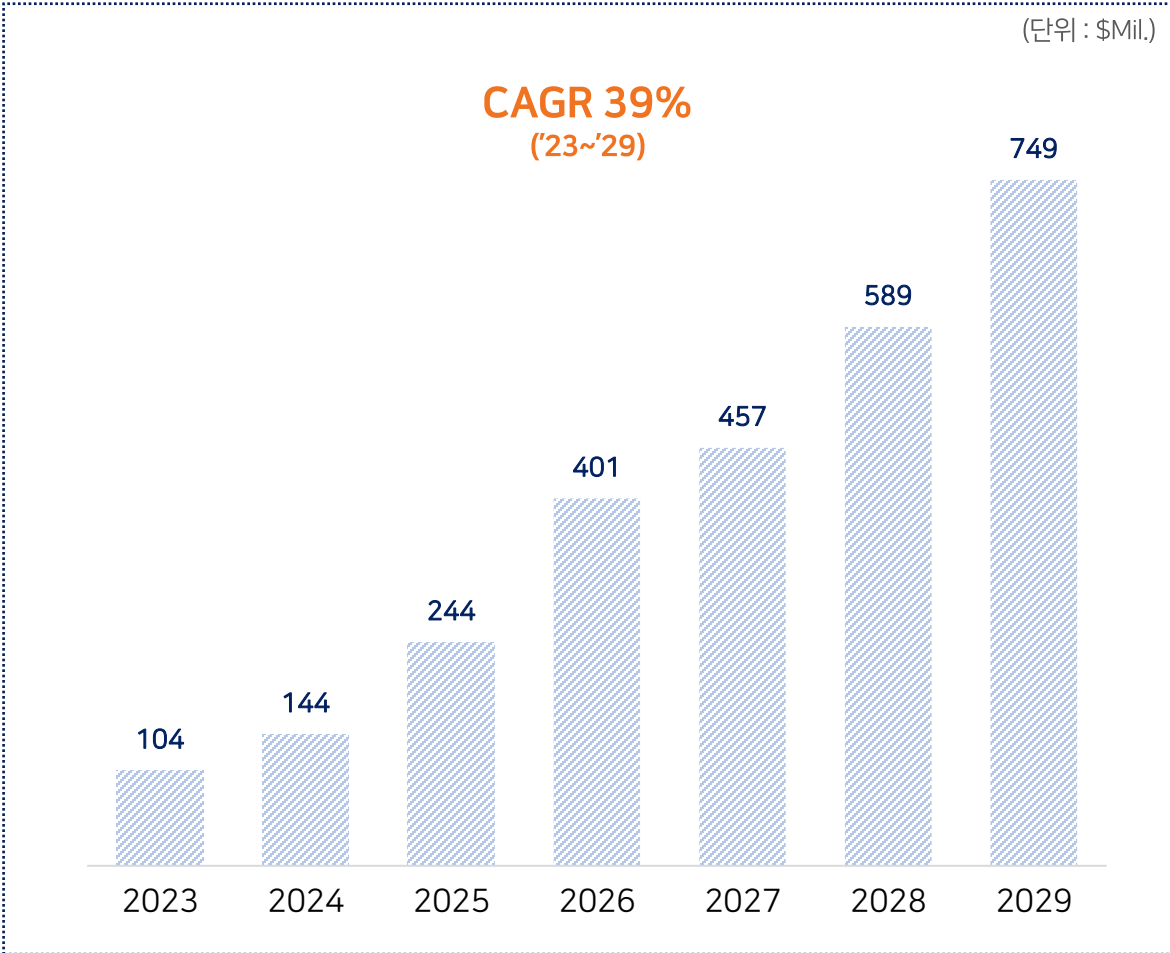


글로벌 보안시장 전망 (*중국시장제외)



(출처 : OMDIA)

Advanced Die Attach 시장

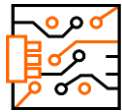


(출처 : Technights, June 2024)

SMT

(Surface Mounting Technology)

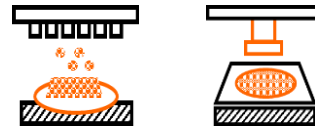
사업 연혁 36년



인쇄회로기판 (PCB)에 다양한 전자부품을
실장하기 위한, 초정밀 Pick & Place와 Vision
Alignment 기술 및 최적화 S/W 솔루션,
주변기기 통합 인라인 솔루션을 보유

반도체 증착, 패키징

사업 연혁 16년 (기술 개발 32년)



고성능 반도체 제조를 위해 필요한
초미세 패터닝 증착 기술과 HBM에
필수인 Advanced Packaging을 위한
다양한 후공정 본딩 기술을 보유

CNC 자동선반, 덴탈밀링

사업 연혁 48년



자동차 부품부터 의료용 부품까지
다양한 소재를 가공하는 초정밀
제어/가공 기술을 보유, 덴탈밀링까지
전방위 제조장비 라인업 구축



SMT 글로벌 대형 고객 확보

수익 확대 및 성장성 확보를 위한 하이엔드 고속기,
인라인 제조 솔루션 기반 사업 강화



반도체 대형사 레퍼런스 기반 사업 확대

국내 대형 고객과의 공동개발 및 평가를 바탕으로
신기술과 시장을 선점하여, 글로벌 시장 공략



초정밀 가공 사업확대

공작기계의 기존 사업구조를 탈피하여,
고수익 전망되는 의료기기 분야로 사업 확장

Advanced Manufacturing Solution Creator



E.O.D